

# 2020-2026年中国高端IC 封装行业前景展望与市场年度调研报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

# 一、报告报价

《2020-2026年中国高端IC封装行业前景展望与市场年度调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202004/158782.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

报告目录：

第一章 高端IC封装行业概述

第一节 IC封装涵盖

第二节 IC封装类型阐述

一、SOP封装

二、QFP与LQFP封装

三、FBGA

四、TEBGA

五、FC-BGA

六、WLCSP

第三节 明日之星--TSV封装

一、TSV简介

二、TSV与SoC

三、TSV产业与市场

第四节 高端IC封装行业产业链模型分析

一、产业链模型介绍

二、高端IC封装行业产业链模型分析

第二章 2016-2019年中国高端IC封装产业运行环境分析

第一节 2016-2019年中国高端IC封装产业经济发展环境分析

第二节 2016-2019年中国高端IC封装产业政策发展环境分析

一、电子产业振兴规划解读

二、IC封装标准

三、内需拉动业，IC业政策与整合是关键

四、集成电路扶持力度加码产业基金规模或达1500亿

五、相关行业政策及对IC封装产业的影响

第三节 2016-2019年中国高端IC封装产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

#### 四、生态环境分析

#### 五、中国城镇化率

#### 六、居民的各种消费观念和习惯

### 第四节 2016-2019年中国高端IC封装产业技术环境发展分析

#### 一、高端IC封装技术

#### 二、中高端IC封装技术有所突破

#### 三、IC封装基板技术分析

## 第三章 2016-2019年世界高端IC封装产业运行走势分析

### 第一节 2019年世界IC封装业运行环境浅析

#### 一、全球经济大环境及影响分析

#### 二、全球集成电路产业运行总况

### 第二节 2019年世界IC封装运行现状综述分析

#### 一、IC封装产业热点聚焦

#### 二、IC封装业新技术应用情况

#### 三、全球IC封装基板市场分析

#### 四、全球IC封装材料市场发展

#### 五、全球IC封装生产企业向中国转移

### 第三节 2019年世界IC封装重点企业运行分析

#### 一、英特尔（Intel）

#### 二、IBM

#### 三、超微

#### 四、英飞凌（Infineon）

### 第四节 2020-2026年世界IC封装业趋势探析

## 第四章 2019年中国IC封装产业整体运行新形势透析

### 第一节 2019年中国IC封装产业动态聚焦

#### 一、半导体封装基板项目落户无锡

#### 二、国内IC封装及IC基板用硅微粉实施产业化

#### 三、中国IC代工封装等已进入国际排行榜

### 第二节 2019年中国IC封装产业现状综述

#### 一、我国IC封装业正向中高端迈进

二、探密中国IC封装产业变局

三、中国正成为全球IC封装中心

四、IC封装年产能分析

第三节 2019年中国IC封装产业差距分析

一、工艺技术

二、质量管理

三、成本控制

第四节 2019年中国IC封装产思考

一、技术上：引进和创新相结合

二、人才上：引进和培养相结合

三、资金上：资本运作是主要途径

第五章 2019年中国IC封装技术研究

第一节 2019年中国IC封装技术热点聚焦

一、封装测试技术新革命来临

二、芯片封装厂封装技术或转向铜键合

三、RFID电子标签的封装形式和封装工艺

四、降低封装成本提升工艺水平措施

第二节 高端IC封装技术

一、IC制造技术

二、TAB Potting System

三、BGA , CSP Ball Mounting System

四、Flip-Chip Bonding System

五、TAB Marking System

六、TFT-LCD Cell Bonding System

第六章 2014年中国高端IC-3D封装市场探析（3D -IC封装）

第一节 3D集成系统分析

一、3D-IC封装

二、3D-IC集成

三、3D-Si集成

第二节 2014年中国高端IC-3D封装发展总况

- 一、3D-IC技术蓬勃发展的背后推动力
- 二、3D-IC封装的快速普及
- 三、3D封装技术将显著提升电源管理器件性能
- 四、3D-IC明后年增温封装大厂已积极布署
- 五、3D封装领域：后进入公司成长空间更大
- 六、3D封装技术解决芯片封装日益缩小的挑战
- 七、3D-IC是半导体封装的必然趋势

### 第三节 高端IC-3D封装研究进展

- 一、3D芯片封装技术创新
- 二、Tb级3D封装存储芯片

### 第四节 3D-IC集成封装系统（SiP）的可行性研究

## 第七章 2019年中国IC封装测试领域深度剖析

### 第一节 2019年中国IC封装测试业运行总况

- 一、IC封装测试业外资独占鳌头
- 二、测试企业布局力度将加大
- 三、中高档封测产品占比将逐年提升
- 四、应对知识产权、环保考验

### 第二节 新型封装测试技术

- 一、MCM（MCP）技术
- 二、SiP封装测试技术
- 三、MEMS技术
- 四、BCC封装技术
- 五、Flash Memory（TSOP）塑封技术
- 六、多种无铅化塑封技术
- 七、汽车电子电路封装测试技术
- 八、Strip Test（条式/框架测试）技术
- 九、铜线键合技术

## 第八章 2019年中国IC封装产业运行新形势透析

### 第一节 2019年中国IC封装产业运行综述

- 一、大陆IC封装企业的分布及其特点

二、IC封装向高端技术迈一步

三、形成封装及自主品牌终端产业链

## 第二节 2019年中国IC封装产业变局分析

一、IC封装业稳步发展，但产值比重有所下降

二、产业格局外企主导，行业竞争日益激烈

三、封装技术更新加快，国内水平显著提高

## 第三节 金融危机对中国IC封装业影响及应对分析

一、金融危机对封装业冲击较大

二、创新使IC封装企业成功渡过危机

## 第四节 2019年中国IC封装业面临的挑战分析

一、低档产品封装产能过剩，高端产品的封装刚刚起步

二、IC业“大进大出”的怪圈对封装业的成长提出了挑战

三、我国IC的相关行业配套能力差，也对封装业造成不利影响

四、技术相对滞后

五、国内封装企业自我研发能力差、研发投入不足

## 第五节 对发展我国IC封装业的思考

# 第九章 2019年中国IC封装细分市场运行分析

## 第一节 手机IC封装市场

### 第二节 手机基频封装

一、手机基频产业

二、手机基频封装

### 第三节 智能手机处理器产业与封装

### 第四节 手机射频IC

一、手机射频IC市场

二、手机射频IC产业

三、4G时代手机射频IC封装

### 第五节 PC领域先进封装

一、DRAM产业近况

二、DRAM封装

三、NAND闪存产业现状

四、NAND闪存封装发展

## 五、CPU GPU和南北桥芯片组

### 第十章 2016-2019年中国高端IC封装所属行业主要数据监测分析

#### 第一节 2016-2019年中国高端IC封装所属行业规模分析

##### 一、企业数量增长分析

##### 二、从业人数增长分析

##### 三、资产规模增长分析

#### 第二节 2019年中国高端IC封装所属行业结构分析

##### 一、企业数量结构分析

##### 二、销售收入结构分析

#### 第三节 2016-2019年中国高端IC封装所属行业产值分析

##### 一、产成品增长分析

##### 二、工业销售产值分析

##### 三、出口交货值分析

#### 第四节 2016-2019年中国高端IC封装所属行业成本费用分析

##### 一、销售成本分析

##### 二、费用分析

#### 第五节 2016-2019年中国高端IC封装所属行业盈利能力分析

##### 一、主要盈利指标分析

##### 二、主要盈利能力指标分析

### 第十一章 中国高端IC封装区域行业市场分析

#### 第一节 东北地区

##### 一、2013-2019年东北地区在高端IC封装行业中的地位变化

##### 二、2013-2019年东北地区高端IC封装行业规模情况分析

##### 三、2013-2019年东北地区高端IC封装行业企业分析

##### 四、2013-2019年东北地区高端IC封装行业发展趋势预测

#### 第二节 华北地区

##### 一、2013-2019年华北地区在高端IC封装行业中的地位变化

##### 二、2013-2019年华北地区高端IC封装行业规模情况分析

##### 三、2013-2019年华北地区高端IC封装行业企业分析

##### 四、2013-2019年华北地区高端IC封装行业发展趋势预测



### 第三节 华东地区

- 一、2013-2019年华东地区在高端IC封装行业中的地位变化
- 二、2013-2019年华东地区高端IC封装行业规模情况分析
- 三、2013-2019年华东地区高端IC封装行业企业分析
- 四、2013-2019年华东地区高端IC封装行业发展趋势预测

### 第四节 华中地区

- 一、2013-2019年华中地区在高端IC封装行业中的地位变化
- 二、2013-2019年华中地区高端IC封装行业规模情况分析
- 三、2013-2019年华中地区高端IC封装行业企业分析
- 四、2013-2019年华中地区高端IC封装行业发展趋势预测

### 第五节 华南地区

- 一、2013-2019年华南地区在高端IC封装行业中的地位变化
- 二、2013-2019年华南地区高端IC封装行业规模情况分析
- 三、2013-2019年华南地区高端IC封装行业企业分析
- 四、2013-2019年华南地区高端IC封装行业发展趋势预测

## 第十二章 2016-2019年中国高端IC封装产品市场竞争格局分析

### 第一节 2016-2019年中国高端IC封装行业竞争力分析

- 一、中国高端IC封装行业要素成本分析
- 二、品牌竞争分析
- 三、技术竞争分析

### 第二节 2016-2019年中国高端IC封装行业市场区域格局分析

- 一、重点生产区域竞争力分析
- 二、市场销售集中分布
- 三、国内企业与国外企业相对竞争力

### 第三节 2016-2019年中国高端IC封装行业市场集中度分析

- 一、行业集中度分析
- 二、企业集中度分析

### 第四节 中国高端IC封装行业五力竞争分析

- 一、“波特五力模型”介绍
- 二、高端IC封装“波特五力模型”分析

#### (1) 行业内竞争

(2) 潜在进入者威胁

(3) 替代品威胁

(4) 供应商议价能力分析

(5) 买方侃价能力分析

## 第五节 2016-2019年中国高端IC封装行业竞争策略分析

## 第十三章 2019年中国封装用材料运行分析

### 第一节 金线

### 第二节 IC载板

## 第十四章 2019年中国分立器件的封装发展透析

### 第一节 半导体产业中有两大分支

#### 一、集成电路

#### 二、分立器件

##### 1、特点

##### 2、应用

### 第二节 分立器件的封装及其主流类型

#### 一、微小尺寸封装

#### 二、复合化封装

#### 三、焊球阵列封装

#### 四、直接FET封装

#### 五、IGBT封装

#### 六、无铅封装

#### 七、几种封装性能同比

### 第三节 2019年中国分立器件的封装现状综述

#### 一、分立器件封装特点

#### 二、分立功率半导体市场在封装革命与集成器件挑战下持续扩张

#### 三、中国分立器件商贸市场分析

#### 四、分立器件封装低端市场竞争激烈

#### 五、分立器件：汽车与照明市场扩容封装重要性凸显

#### 六、封装产品结构调整分立器件价格影响

#### 七、集成电路及分立器件封装测试项目

## 第十五章 2016-2019年中国高端IC封装行业市场需求分析

### 第一节 2016-2019年中国压高端IC封装下游行业需求结构分析

#### 第二节 半导体行业高端IC封装需求分析

- 一、半导体行业发展现状与前景
- 二、半导体行业领域高端IC封装应用现状
- 三、半导体行业对高端IC封装的需求规模
- 四、半导体行业高端IC封装行业主要企业及经营情况
- 五、半导体行业高端IC封装需求前景

#### 第三节 芯片行业高端IC封装需求分析

- 一、芯片行业发展现状与前景
- 二、芯片领域高端IC封装应用现状
- 三、芯片行业对高端IC封装的需求规模
- 四、芯片用高端IC封装行业主要企业及经营情况
- 五、芯片行业高端IC封装需求前景

#### 第四节 下游三行业高端IC封装需求分析

- 一、下游三行业发展现状与前景
- 二、下游三领域高端IC封装应用现状
- 三、下游三行业对高端IC封装的需求规模
- 四、下游三用高端IC封装行业主要企业及经营情况
- 五、下游三行业高端IC封装需求前景

#### 第五节 下游四行业高端IC封装需求分析

- 一、下游四行业发展现状与前景
- 二、下游四领域高端IC封装应用现状
- 三、下游四行业对高端IC封装的需求规模
- 四、下游四用高端IC封装行业主要企业及经营情况
- 五、下游四行业高端IC封装需求前景

#### 第六节 下游行业发展对高端IC封装影响因素分析

## 第十六章 2019年中国半导体（集成电路）封装重点企业运营财务状况分析

### 第一节 长电科技（600584）

#### 一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

## 第二节 深圳赛意法微电子有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

## 第三节 南通富士通微电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

## 第四节 中芯国际集成电路制造（天津）有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

## 第五节 英特尔产品（成都）有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

## 第六节 无锡菱光科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

## 第七节 恒宝股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

## 第八节 南京汉德森科技股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

## 第九节 深圳市比亚迪微电子有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

## 第十节 常州市欧密格电子科技有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

## 第十七章 2020-2026年中国高端IC封装产业发趋势预测分析

### 第一节 2020-2026年中国IC封装业前景预测

一、环氧树脂在电子封装应用方面前景开阔

二、太阳能光伏行业对封装材料需求前景光明

### 第二节 2020-2026年中国IC封装产业新趋势探析

一、新型的封装发展趋势

二、集成电路封装的发展趋势

三、IC封装技术发展趋势

四、IC封装材料市场发展趋势

五、半导体IC封装技术发展方向

### 第三节 2020-2026年中国IC封装市场前景预测

一、2020年先进电子封装市场预测

二、全球19家IC封装厂家收入预测

三、中国IC封装市场规模预测

## 第十八章 2020-2026年中国高端IC封装行业发展策略及投资建议

### 第一节 高端IC封装行业发展策略分析

一、坚持产品创新的领先战略

二、坚持品牌建设的引导战略

三、坚持工艺技术创新的支持战略

四、坚持市场营销创新的决胜战略

五、坚持企业管理创新的保证战略

### 第二节 高端IC封装行业市场的关键客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

## 第十九章 2020-2026年中国高端IC封装行业投资机会与风险分析

### 第一节 2020-2026年中国高端IC封装行业投资环境分析

#### 第二节 2020-2026年中国高端IC封装行业投资特性分析

- 一、2020-2026年中国高端IC封装行业进入壁垒分析
- 二、2020-2026年中国高端IC封装行业盈利模式分析
- 三、2020-2026年中国高端IC封装行业盈利因素分析

### 第三节 2020-2026年中国高端IC封装行业投资机会分析

- 一、高端IC封装投资潜力分析
- 二、高端IC封装投资吸引力分析

### 第四节 2020-2026年中国高端IC封装行业投资风险分析

- 一、市场竞争风险分析
- 二、政策风险分析
- 三、技术风险分析

## 图表目录：

图表 2013-2019年中国GDP增长变化趋势图

图表 2013-2019年中国消费价格指数变化趋势图

图表 2013-2019年中国城镇居民可支配收入变化趋势图

图表 2013-2019年中国农村居民纯收入变化趋势图

图表 2013-2019年中国社会消费品零售总额变化趋势图

图表 2013-2019年中国全社会固定资产投资总额变化趋势图

图表 2013-2019年中国货物进口总额和出口总额走势图

图表 2013-2019年中国高端IC封装产量情况

图表 2019年我国高端IC封装消费结构表

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202004/158782.html>